公司代码:603061　　公司简称:金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
电话	021-52277906	021-52277906
办公地址	上海市青浦区嘉松中路 2188 号	上海市青浦区嘉松中路 2188 号
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,638,295,281.11	2,149,652,155.84	22.73
归属于上市公司股东的净资产	1,896,731,445.64	1,614,293,008.86	17.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	600,713,563.49	307,416,004.67	95.41
利润总额	197,368,161.29	85,797,373.60	130.04
归属于上市公司股东的净利润	171,174,638.22	76,005,538.68	125.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,553,119.22	73,814,096.57	128.35
经营活动产生的现金流量净额	57,817,362.44	16,576,701.41	248.79
加权平均净资产收益率(%)	9.93	5.61	增加 4.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.01	0.90	123.33
稀释每股收益(元/股)	1.99	0.90	121.11

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	18,295
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
崔学峰	境内自然人	14.19	12,341,141	0	质押	3,697,500
龙波	境内自然人	8.91	7,749,012	0	质押	768,500
香港中央结算有限公司	境外法人	8.83	7,678,383	0	无	0
宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.95	6,918,798	0	质押	2,436,000
南通华泓投资有限公司	境内非国有法人	6.20	5,393,206	0	无	0
钟格	境内自然人	4.06	3,530,000	0	无	0
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.63	3,153,958	0	无	0
天津金海通半导体设备股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	2.89	2,515,417	0	无	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14	989,650	0	无	0
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	其他	1.08	940,925	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人,崔学峰与龙波为一致行动人; 2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-061

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事,会议补充通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 7 人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于(公司 2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于(公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为 2026 年半年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-062)。

(三)审议通过《关于(公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

公司为深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,于 2025 年 12 月制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。2026 年上半年,公司根据行动方案积极落实相关举措,认真评估实施效果,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

此议案获得通过。

(四)审议通过《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为消除长期租赁带来的经营不确定性、提升海外生产运营中心的稳定性,公司拟使用已终止的“年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金中的 2,300 万元实施全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.(马来西亚槟城金海通)的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”,并将剩余募集资金 1,170.52 万元永久补充流动资金。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-065)。

本议案审议通过后,尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第四次临时股东会,审议如下议案:

序号	审议事项
1	《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-066)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-062

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定,现将天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000.00 股,每股发行价为人民币 58.58 元,募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元(不含税)后,募集资金净额为 746,811,874.91 元,该募集资金已于 2023 年 2 月 24 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 60,317.76 万元,募集资金账户余额为人民币 13,109.65 万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月24日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	87,870.00
减:直接支付发行费用	13,188.81
二、募集资金净额	74,681.19
减:	
截至 2025 年 12 月 31 日已使用金额	53,804.08
2026年1-6月使用金额	6,513.68
现金管理金额	3,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
加:	
募集资金利息收入	2,146.39
三、报告期期末募集资金余额	13,109.65

注:以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2023年2月24日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态		
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	12,833.02	使用中		
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	64.36	使用中		
江苏金海通半导体设备有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	212.27	使用中		
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995	0	已注销		
合计			13,109.65			

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 60,317.76 万元,具体使用情况详见附表 1:2026 年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 3.2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等,自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,保荐机构出具了核查意见。

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议,2026 年 2 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 2.2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等,自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年2月24日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
32,000	投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品	2025年2月26日	2026年2月25日	2025年2月26日
22,000	投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品	2026年2月3日	2027年2月2日	2026年2月3日

募集资金现金管理明细表

单位:元 币种:人民币

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收益或损失
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	35,000,000.00	2025年12月11日	2026年1月14日	1.60%	52,164.38
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2026年1月4日	2026年1月30日	1.90%	205,833.33
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2026年2月9日	2026年2月26日	1.55%	109,791.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	34,000,000.00	2026年2月12日	2026年4月15日	1.60%	92,405.48
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	150,000,000.00	2026年3月2日	2026年3月31日	2.00%	241,666.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	140,000,000.00	2026年4月7日	2026年4月30日	2.00%	178,888.89
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	34,000,000.00	2026年4月23日	2026年5月27日	1.50%	47,506.85
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	140,000,000.00	2026年5月8日	2026年5月15日	1.50%	40,833.33
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	140,000,000.00	2026年5月18日	2026年5月29日	1.50%	64,166.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	120,000,000.00	2026年5月31日	2026年6月30日	1.80%	174,000.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	34,000,000.00	2026年6月4日	2026年7月8日	1.50%	47,506.85

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意公司终止募投项目“年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”,并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理,公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资,保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

附表 1:2026 年半年度募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2023年2月24日										
本年度投入募集资金总额	6,513.68										
已累计投入募集资金总额	60,317.76										
变更用途的募集资金总额	3,205.05										
变更用途的募集资金总额比例	4.29%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	研发项目	否	43,615.04	不适用	43,615.04	6,509.78	32,567.80	-11,047.24	74.67	2026年10月	不适用	不适用	否
年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	生产建设	是	11,066.15	7,861.10	7,861.10	3.90	7,636.96	-224.14	97.15	已终止(注1)	不适用	不适用	是
	其他-暂未确定投向			3,205.05	3,205.05	0	0	-3,205.05	0	暂未确定投向	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	0	20,113.00	113.00(注2)	100.57	—	—	—	—
合计			74,681.19	—	74,681.19	6,513.68	60,317.76	-14,363.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

注 1:公司终止募投项目“年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”,并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理,公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-024)以及于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

注 2:补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

注 3:“年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”已终止,但截至 2026 年 6 月 30 日止,实际投资金额与募集后承诺投资金额之间尚存 224.14 万元差额(系根据合同计算的暂估金额,最终以项目实际支付为准),上述差额因相关款项尚未完成支付所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2023年2月24日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目		生产建设	江苏金海通半导体设备有限公司	江苏省南通市	7,861.10	7,861.10	3.90	7,636.96	97.15	已终止	不适用	不适用	不适用	2025年5月29日	2025年6月16日
合计					7,861.10	7,861.10	3.90	7,636.96	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用														
募集资金结余的金额及形成原因	不适用														
募集资金其他使用情况	无														

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-063

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩 说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 10 日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 3 日(星期四)至 9 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预征集问答”栏目或通过天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 27 日(星期四)发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 10 日(星期四)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 10 日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士和独立董事孙晓伟先生等(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 10 日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 3 日(星期四)至 9 月 9 日(星期三)前登录上证路演中心网站首页,点击“预征集问答”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jhtdesign@jht-design.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:021-52277906

邮箱:jhtdesign@jht-design.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-064

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于参加 2026 年天津辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 9 月 3 日(周四)15:00-17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书刘海龙先生(具体参会人员将根据实际情况进行调整)将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-065

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于拟使用已终止的募投项目部分 剩余募集资金实施新增募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟使用已终止的“年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金中的 2,300 万元实施全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.(以下简称“马来西亚槟城金海通”)的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”,并将剩余募集资金 1,170.52 万元永久补充流动资金。

● 变更募集资金投资项目审议程序:公司于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000.00 股,每股发行价为人民币 58.58 元,募集资金总额为人民币 878,700,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元(不含税)后,募集资金净额为 746,811,874.91 元,该募集资金已于 2023 年 2 月 24 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	87,870.00
募集资金净额	74,681.19
募集资金到账时间	2023年2月24日
涉及变更投向的总金额	3,470.52
涉及变更投向的总金额占比	4.65%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 √永久补充流动资金 □其他:____

注:涉及变更投向的总金额包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等,具体金额以实际结转时专户实际余额为准。

(二)本次实施新增募集资金投资项目的情况

公司拟将已终止的募投项目“年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金 3,470.52 万元(包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等,具体金额以实际结转时专户实际余额为准)中的 2,300 万元实施全资子公司马来西亚槟城金海通的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”,并将剩余募集资金 1,170.52 万元永久补充流动资金。本次拟变更投向的募集资金总金额占公司 2023 年首次公开发行股份募集资金净额的 4.65%。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会审计委员会第二十三次会议,并于 2026 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时,董事会提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜;授权公司管理层全权办理本次境外资产购买相关事宜,包括但不限于确定交易对价,确定律师咨询、代理机构等第三方中介及其服务费用,签署相关交易文件,支付全部交易款项,完成资产交割、产权办理等事宜。本次实施新增募投项目不构成关联交易,不构成重大资产重组,本事项尚需提交公司股东会审议。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截至公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年首次公开发行股份	年产 1,000 台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	江苏金海通半导体设备有限公司	江苏省南通市	11,066.15	11,066.15	7,847.81	7,836.23	是	2023年首次公开发行股份	购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目	JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.(马来西亚槟城金海通)	马来西亚	2,300	2,300	否
										永久补充流动资金	天津金海通半导体设备股份有限公司	不适用	1,170.52	1,170.52	否
合计				11,066.15	11,